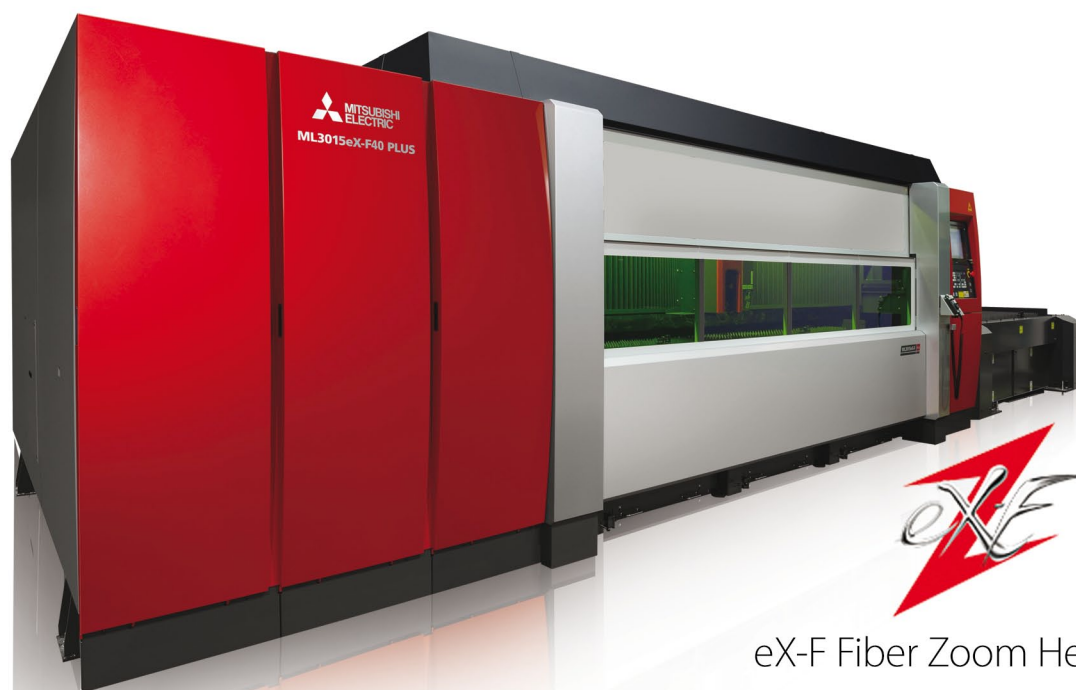


Zaufaj japońskiej technologii

Systemy laserowe 2D Fiber Mitsubishi Electric

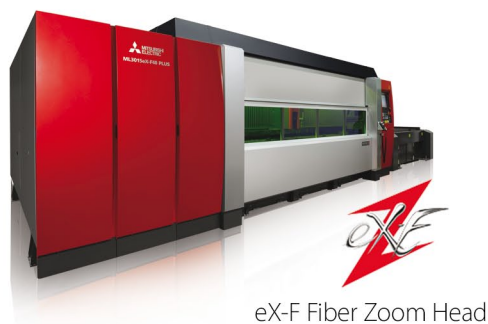


eX-F Plus

Processing Performance

Wycinarki laserowe **Mitsubishi eX-F Plus** oparte na technologii światłowodowej doskonale nadają się do szybkiej i precyzyjnej obróbki cienkiej stali zwykłej, nierdzewnej oraz aluminium. Dzięki najnowszym rozwiązaniom z powodzeniem mogą być stosowane także do cięcia stali grubych i średniej grubości.

Technologia światłowodowa Mitsubishi to maksymalna wydajność przy jednocześnie niskich kosztach eksploatacyjnych. Maszyny zapewniają maksymalny komfort pracy i bezpieczeństwa dla operatora, są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Produkcja i finalny montaż odbywają się w Japonii.



Wycinarki laserowe eX-F Plus to:

- wysoka wydajność
- niezawodność
- bezpieczeństwo
- niskie koszty eksploatacyjne
- komfort pracy
- prosta obsługa

Specyfikacja techniczna

Budowa maszyny	Rezonator typu fiber, dwa wymienne stoły
Dostępna moc rezonatora	4000W, 6000W
Sterowanie	M700 Mitsubishi, 15" ekran dotykowy,
Maks. obszar roboczy	1525 x 3050 mm
Maks. waga arkusza	930 kg
Wymiary zewnętrzne	10340 x 3130 x 2250 mm
Waga maszyny	11 000 kg
Zakres pracy osi X/Y/Z	3100/1565/150 mm
Czas rozruchu	3 min
Prędkość symultaniczna oś X, oś Y	140m/min
Dokładność pozycjonowania	0,05/500mm (oś X,oś Y)
Powtarzalność pozycjonowania	0,01mm (oś X,oś Y)
Głowica	PH-S2 Mitsubishi, Auto Focus, soczewki 5" oraz 8" eX-F40 - głowica typu Zoom Head - opcjonalnie eX-F60 - głowica typu Zoom Head - standardowo

Zakres cięcia

	4000 W	6000 W
stal czarna	0,5 - 19 mm / 25 mm *	0,5 - 25 mm
stal nierdzewna	0,5 - 20 mm	0,5 - 25 mm
aluminium	0,5 - 15 mm	0,5 - 25 mm
mosiądz	0,5 - 12 mm	0,5 - 12 mm
miedź	0,5 - 6 mm	0,5 - 6 mm

*) możliwe do uzyskania przy użyciu opcji dodatkowej - zestaw do cięcia stali grubej (TMSCEF)

Uwaga !

Zakres grubości i jakość cięcia zależy od jakości materiału wejściowego oraz od specyfiki kształtu wycinanego elementu. Największa efektywność laserów opartych na technologii typu „fiber” jest uzyskiwana przy cięciu cienkich materiałów w zakresie 0,5 – 5 mm.